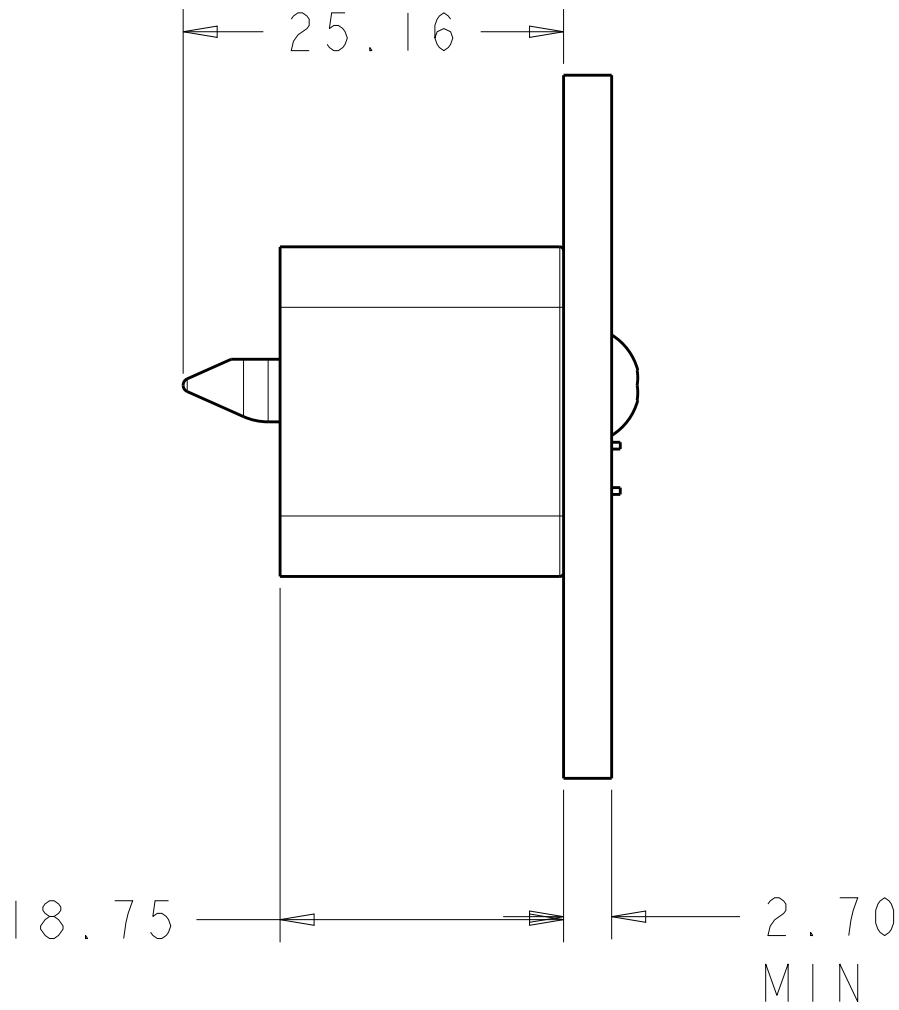
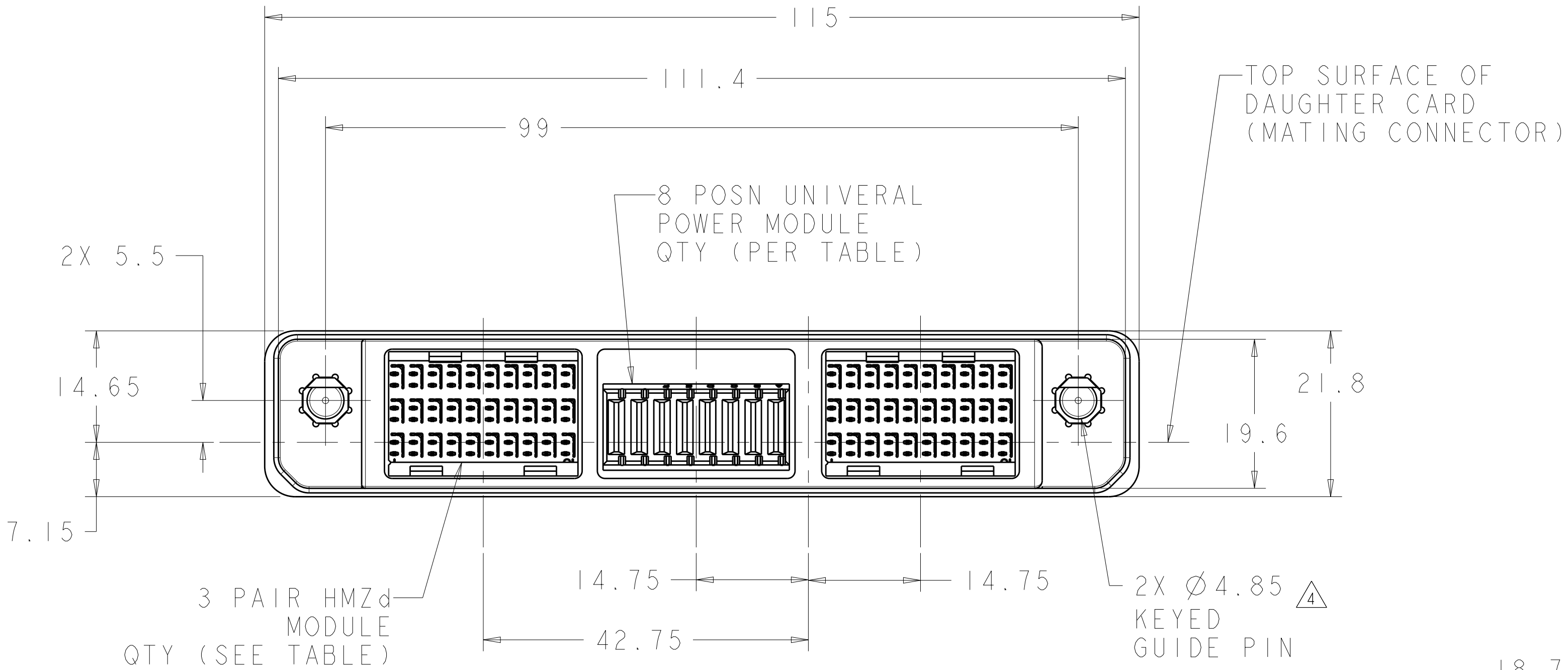
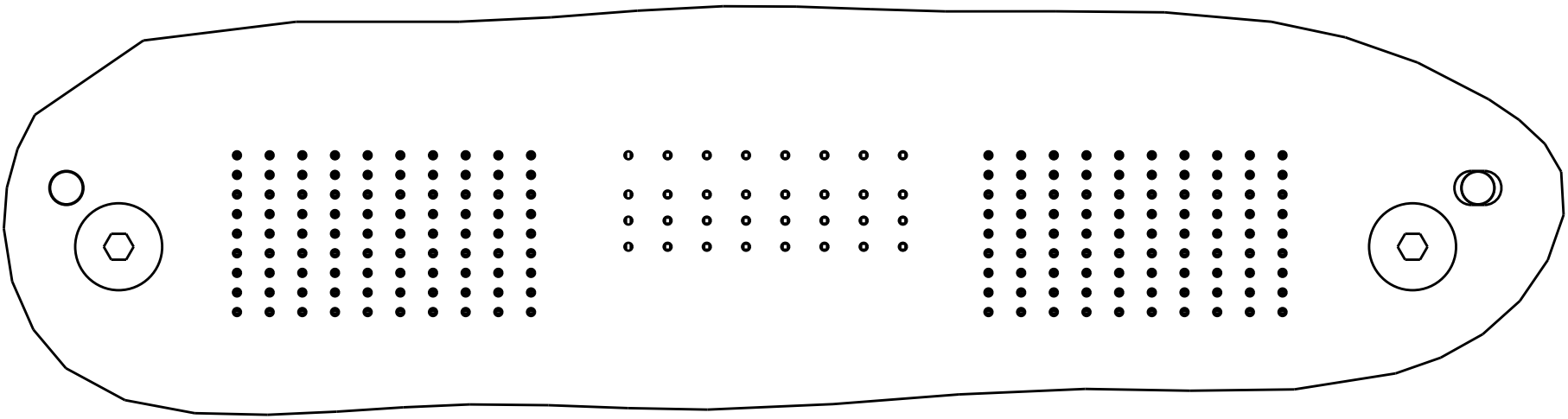
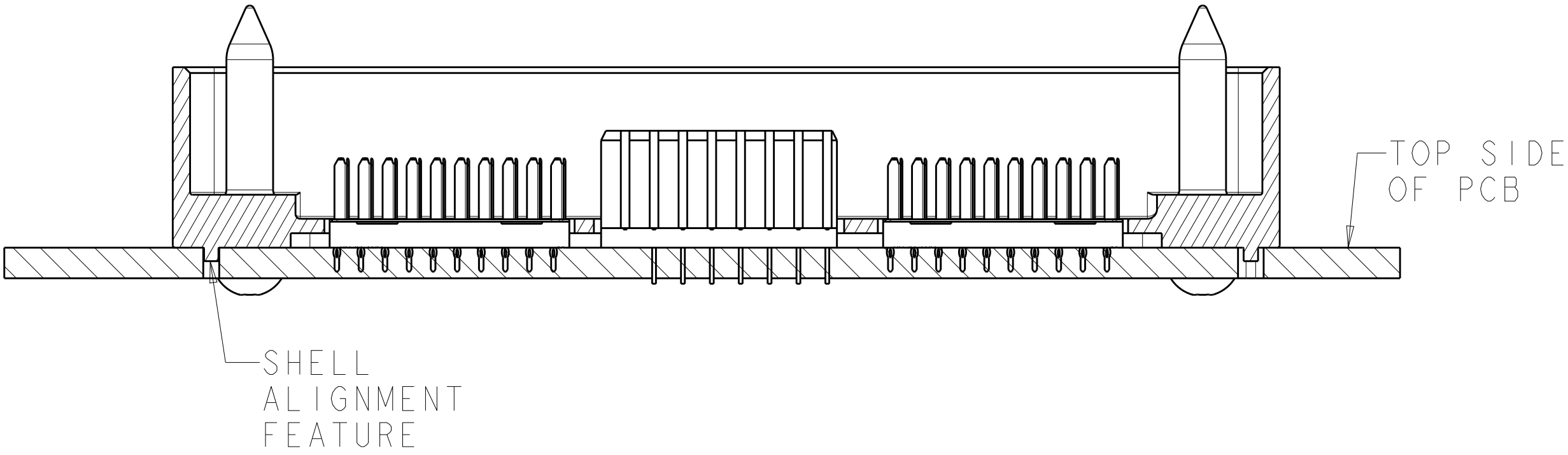


LOC		DIST		REVISIONS						
-		-		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
			G			REV PER ECO 15-010033		7-10-15	CT	DH



1. MATING CONNECTOR FOR THIS CONNECTOR IS 2000979.
2. MATERIAL- SHELL: ALUMINUM
HOUSING: GLASS FILLED POLYESTER, UL94VO
RETAINING RING: STAINLESS STEEL
KEYING GUIDE PIN: STAINLESS STEEL
3. PLATING- SHELL: ELECTROLESS NICKEL
4. KEYING GUIDE PIN PACKAGED FOR ASSEMBLY BY CUSTOMER.
5. PLATING- CONTACT MATING AREA:
1.27µm MIN GOLD OVER 1.27µm MIN NICKEL
CONTACT PCB AREA: 0.5µm MIN TIN
OVER 1.27µm MIN NICKEL



OBSOLETE

NOT RELEASED FOR PRODUCTION

OBSOLETE

OBSOLETE

OBSOLETE

2	1	--	--	5-2000980-4
2	1	--	--	5-2000980-3
--	1	1	1	2000980-6
--	-	-	3	2000980-5
--	1	-	2	2000980-4
--	1	-	2	2000980-3
--	1	1	1	2000980-2
--	-	-	3	2000980-1
3 PAIR HMZd MODULE (RoHS)	8 POSN UPM MODULE	7 POSN RF COAX MODULE	3 PAIR HMZd MODULE	PART NUMBER
MODULE QTY PER ASSY				

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN Brent D. Toth CHK CHONG YI APVD M. R. McALONIS	13JAN2010 13JAN2010 13JAN2010	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ±0.025 4 PLC ± ANGLES ±°		NAME MOTHER BOARD CONNECTOR, HIGH SPEED RUGGEDIZED (HSR), 3 BAY, UNSEALED, VERTICAL	

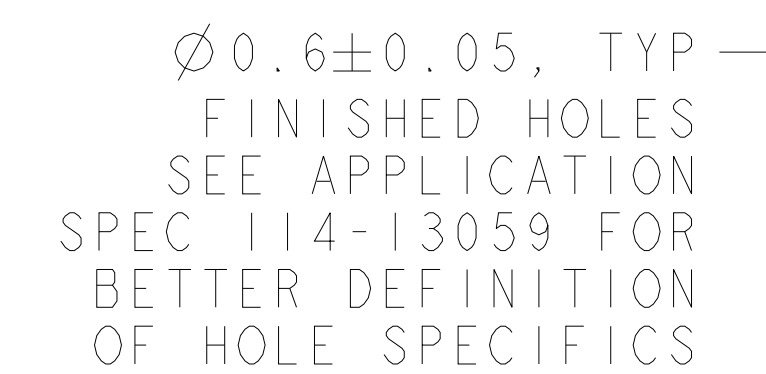
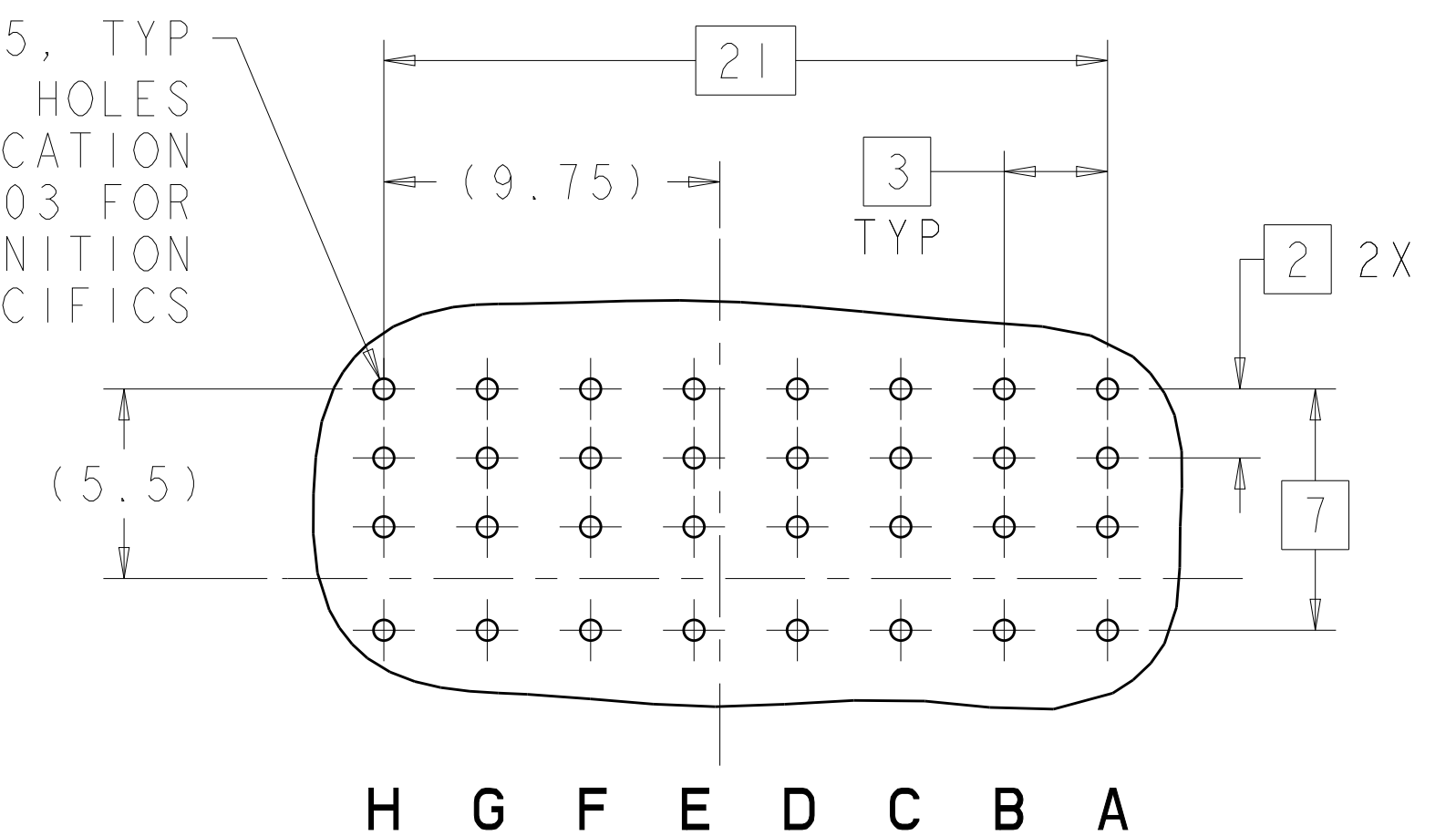
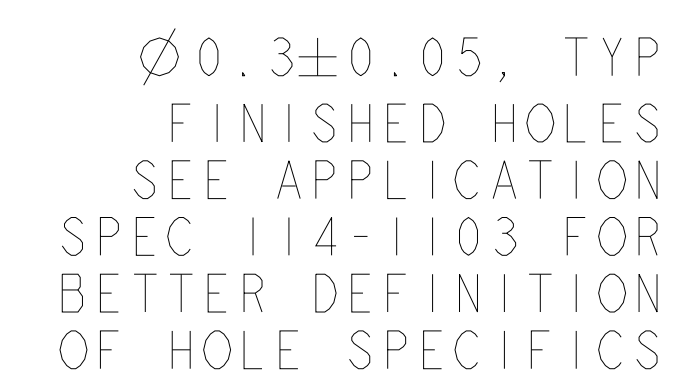
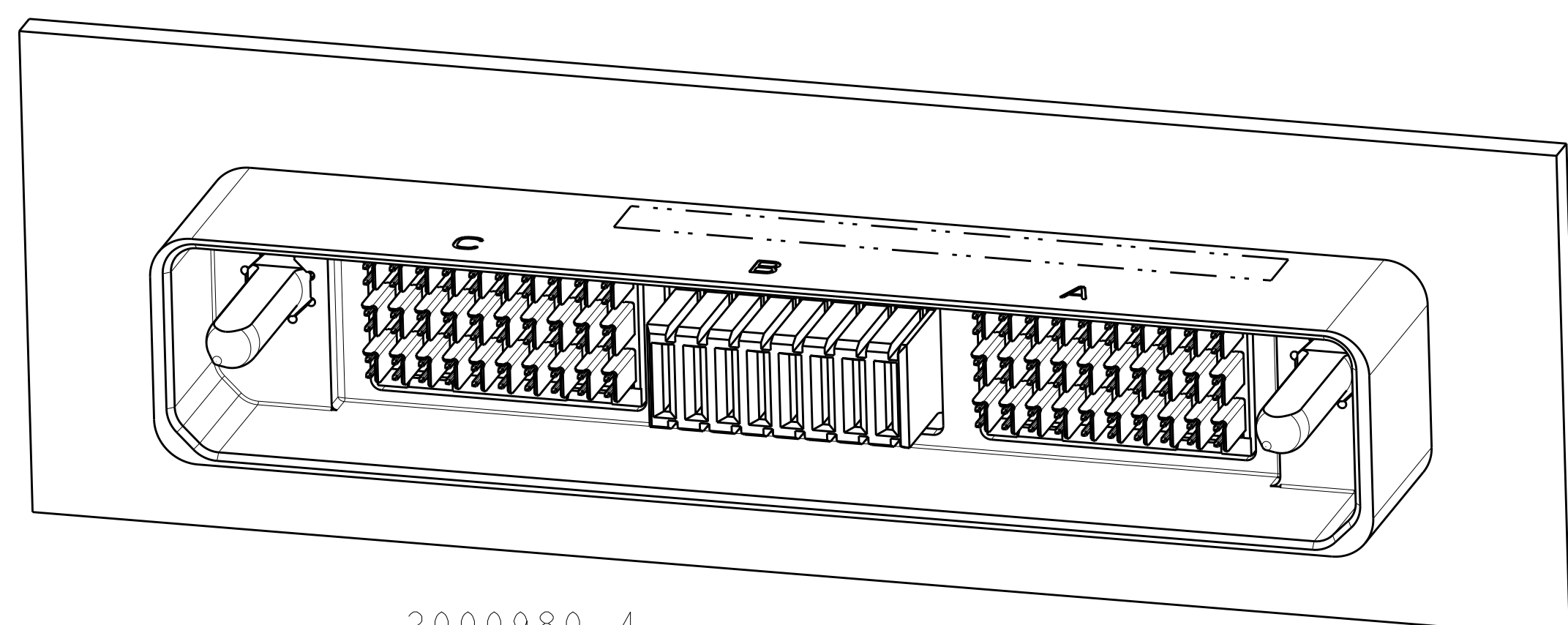


Diagram illustrating a 10x8 array of pins (80 pins total) arranged in a 3-pin HMZd format. The array is defined by dimensions 22.5 (width) and 12 (height). The pin rows are labeled ROW FG (GND) through ROW A. The pin columns are numbered 1 through 10. The diagram shows a 10x8 grid of pins. Dimensions include 11.7 for the first 5 columns, 1.5 for the first column offset, and 1.5 for the last column offset. Notes specify 3 PAIR HMZd, TYP 2X FOR -4, and TYP 3X FOR -5.

2000980-4 PCB
SCALE 2:1



8 POSITION
UNIVERSAL POWER MODULE
DETAIL K
SCALE 5:1



2000980-4
SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 13JAN2010 Brent D. Yoho CHK 13JAN2010 CHONG YI APP'D M.R. McALONIS 13JAN2010		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.05 3 PLC ±0.025 4 PLC ±.1 ANGLES ±.1		NAME MOTHER BOARD CONNECTOR, HIGH SPEED RUGGEDIZED (HSR), 3 BAY, UNSEALED, VERTICAL	
MATERIAL - FINISH - SEE TABLE		WEIGHT - CUSTOMER DRAWING		SIZE A1 CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C=2000980 RESTRICTED TO -	
				SCALE 1:1 SHEET 2 of 3 REV G	

4805 (3/11)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9